



RE900-05

- Fibre de verre FR4 époxyde 1,50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique et un laque d'arrêt de soudure
- Platine d'adaptation pour TSOP II 40, 44 (0,80 mm)
- Perforation 1,00 mm Ø
- Les données Data Gerber d'apprêt pour l'établissement de l'application de pâte à braser seront mis à la disposition gratuitement
- Dimensions 29,29 x 30,94 mm

Module-No.	Type	Pitch	Pin	Dimensions (mm)
RE900-05	TSOP II	0,800 mm	40, 44	11,50 x 18,80